# 卒業研究報告

題 目

## MeV イオンビームのチャネリング軌道計算

指導教員

成沢 忠

報告者

高田 宜功

平成 14 年 2 月 5 日

高知工科大学 電子・光システム工学科

# 目次

### 1. 序論

- 1.1 物質解析の基礎
- 1.2 ラザフォード後方散乱法の歴史
- 1.3 ラザフォード後方散乱法の基本概念
- 1.4 チャネリング現象

### 2. 人工チャネル

- 2.1 ガラスキャピラリによる人工チャネル
- 2.2 ガラスキャピラリ内の MeV イオンビームの軌道計算(鏡面反 射の場合)
- 2.3 ガラスキャピラリ内壁によるイオンビーム散乱の角度分布計算

### 3. 考察および結論

### 参考文献リスト

### 謝辞

### 1. 序論

現在、固体分析には数多くの手法が存在する。その中でも分析手法として 多く利用されているのがラザフォード後方散乱法(RBS)である。RBS法は、 H+や He+イオンなどの軽い高速イオンを物質中に打ち込み、原子の原子核との 衝突により後方散乱(ラザフォード後方散乱)されたイオンのエネルギー分析 から、物質の組成を調べることができる手法である。現在の RBS 法での入射 イオンビームの直径は1mm 程度が主流である。しかし、電子デバイスや光デ バイスはとても高精細化してきていて、この傾向はさらに続くことが予想され る。そんな中、直径が1mm 程度もあるイオンビームではきわめて不十分な情 報しか得られない場合も多い。そこで入射イオンビームを0.1 µm 程度まで収 束させるためにガラスキャピラリを使った実験が成沢教授の研究室グループで 計画されている。現在でも電磁界レンズを用いてイオンビームを1 µm 程度ま で収束させる技術はあるが、非常に大型となりコストもかかる。ガラスキャピ ラリを使うイオンビーム収束の研究は、今のところまだシミュレーション計算 の段階で、これまではすべてのイオンがガラス壁面に衝突したら鏡面反射され るものと仮定している。

本論文では、まずこれまでの根引らの計算を再確認した後、ガラス壁面によ るイオン散乱の角度分布を考慮に入れれば、より現実に近いシミュレーション 結果が得られることを期待して、簡単なモデルを仮定して計算を行った。

ここでは、第1章で固体分析について説明し、第2章で現在行われているガ ラスキャピラリによるイオンビーム収束実験についての説明と散乱角度分布計 算の結果を紹介する。

#### 1.1 物質解析の基礎

物質解析手法は、放射線源・粒子線の種類(光子、電子、中性子、イオンなど)・相互作用の断面積・放出される放射線の種類・検出系などによって特徴づけられる。図1.1は固体へのイオン衝突により放出される各種信号を表わしたものである。これら各種信号のどれを検出するかによって、以下に示すようなさまざまな分解手法が実現できる。



図1.1 イオン衝突により生成される各種信号

入射粒子と放出粒子の種類によって、いくつかの固体分析手法を列挙してみる。

A. 同種の放射線が入射と出射の場合

- 1.電子(入射)電子(出射)
  オージェ電子分光法(AES)
- イオン(入射)、イオン(出射)
  ラザフォード後方散乱法(RBS)
- 3、X 線(入射) X 線(出射)
  蛍光 X 線分光法(XRF)

B. 異種の放射線が入射と出射の場合

X 線(入射) 電子(出射)
 X 線光電子分光法(XPS)

2 . 電子(入射 ) X 線(出射 )

電子マイクロ分析法 (EMA)

3.イオン(入射) 試料イオン(出射)

二次イオン質量分析法(SIMS)

ターゲットに入射した粒子は、ある場合は弾性的に散乱され、ある場合には ターゲット原子内で電子遷移を起こさせる。ターゲットの単位面積当たりの 原子の個数は、入射粒子の個数(I)と相互作用が起きた回数との間の関係から 計算される。入射粒子と原子の相互作用の起こりやすさの定量的な尺度となる のが断面積である。あるプロセスについての原子の断面積()は、そのプロ セスが起きる確立(P)を使って表すと、

P=(相互作用が起きた回数)/(入射粒子の個数)= Nt

と定義される。

入射粒子に垂直な単位面積当たりに Nt 個の原子を含むターゲットに I 個の 粒子が入射したとすると、相互作用が起こる回数は I Nt となる。ここで、I は別個で測定できるから、断面積がわかっているプロセスの出射粒子を計測す れば、ターゲット原子の個数、つまり組成が求められる。散乱された粒子や出 射線のエネルギーは、ターゲット原子の情報を持っている。物質解析で得られ る情報は、原子の種類・濃度・深さ方向の分布・構造などである。

図1.2に散乱断面積の概念を示す。



図1.2 散乱断面積の概念図

図1.2において、単位面積内に5個の散乱中心(原子)があって、それぞれの原 子の散乱断面積が単位面積の1/30であるとするならば、入射粒子のうち5×1/30=1/6 が散乱されることになる。

#### 1.2 ラザフォード後方散乱法の歴史

1900年代初め、ラザフォードは、ラジウムからの崩壊生成物として放射 される 線の金属板による反射率を測定していて、重い金属ほど反射率が 大きいことに気がついた。そこで板の厚さを調べるために薄い金箔で実験 を行ったところ 線の反射は厚い金板のときの10分の1以上も観測された。 次に、金箔を重ねてみると、はじめの数枚での反射率は枚数に比例した。 これは、 線の反射が、金の原子との1回の衝突による散乱結果である事 を示している。このように1回の衝突で大きな散乱をするには原子の内部 で電荷が一様に分布していると考えていては説明できない。そこでラザフォ ードは原子の中心に正の電荷をもつ極めて小さく重いもの、すなわち原子 核が存在することを示したのである(1911)。このように歴史上、原子や 原子核の構造は粒子の散乱実験で得られてきたものであるが、現在では この原子核による 線の散乱は、試料についてのさまざまな情報を知る 有力な手段となっている。

#### 1.3 ラザフォード後方散乱法の基本概念

原子や原子核の構造は、粒子の散乱実験で得られてきた。素粒子(光子、電 子、中性子、イオンなど)のビームを既知の原子・原子核と衝突させ、散乱を 計測する事によって相互作用を知る事ができる。逆に、未知のターゲット (固体)に直接、数百万ボルト(MeV)のエネルギーをもつイオンを入射し、 それが原子によって散乱されるとき、散乱粒子の強度とエネルギーを計測する ことでターゲットの組成(元素の種類と量)や構造(深さ方向、分布と配列の 状態)が分かり、その結果からターゲットを解析する事ができる。これがラザ フォード後方散乱法(RBS)の基本的概念である。

ラザフォードが示した原子核同士のクーロン散乱は「ラザフォード散乱」 と呼ばれている。RBS法では、数百万電子ボルト(MeV)まで加速したH<sup>+</sup> や He<sup>+</sup>イオンなど軽い高速イオンビームを物質中に打ち込み、原子の原子核 とのラザフォード散乱により後方散乱されたイオンのエネルギー分析によっ て、物質の構成を知ることができる。この RBS 法では、試料の組成や深さ 方向の分布を表面から数µmのところまで約100 という精度で知ること ができる。しかも、数mm四方で厚さ数μm以上という少量の試料しか必要 とせず、それをほとんど破壊することなく(非破壊試験) 多くの場合1時間 以内という短時間で正確な情報が得られる。この時の散乱過程で入射イオン は一定のエネルギーを相手側の原子核に反跳エネルギーとして与える。さら に、物質中の電子とイオンとの相互作用によってエネルギーが失われる。こ のように、入射イオンがエネルギーを失う過程には原子核との相互作用と 電子との相互作用の2種類があるが、これらはイオンの速度で異なることが 知られている。速度が大きいほど相互作用は小さくなる。つまり、高速イオ ンほど飛程が大きい。これらの散乱過程は大きく「弾性散乱」と「非弾性散 乱」の二つに分類される。まず、弾性散乱とは、散乱前にイオンおよび散乱体 (物質中の原子)のもっていた全運動エネルギーが散乱後も保存される場合 のことで、これに対して非弾性散乱では全運動エネルギーの一部がほかのエ ネルギーに変わってしまう(電子励起にエネルギーが消費される、など)ため 保存されない。この2つの異なる散乱過程は同時に起こっているが、どちらが 主として起こるかは原子の軌道運動速度(Ve)に対してのイオン速度(Vi)に よって決まる。

- (1) Vi > Ve の場合は"高速イオン"で運動するイオンと軌道電子間に生じるクーロン相互作用の時間的変化が激しくなり電子励起が起こる。
- (2) Vi Ve の場合は"低速イオン"で、相互作用はゆっくりと変化する ので電子励起は無視できる。

ここで、軌道運動速度(Ve)は一般的に10<sup>8</sup> cm/s の桁である。

イオンの原子量をNとすると、イオンの運動エネルギー(Ei)がN(keV) 以上になれば電子励起を起こしやすくなることが知られている。したがって、 高速イオンと低速イオンの境界となるエネルギー値は、

#### Ei = N (keV)

で表わされる。

よって、N=4のHe+イオンをMeV領域まで加速すれば、完全な高速 イオン領域となる。したがって、この場合には、イオンのエネルギー損失は 主として電子との相互作用によって起こり、原子核との衝突はごくまれにし か起こらない。

RBS 法で使用する高速イオンは弾性散乱の確率が非常に小さい。イオン ビームは原子核による散乱ではイオンのエネルギーとともに軌道の方向も変 化するが、電子との衝突過程では、電子が持っている運動エネルギーは数 eV から数十 eV 程度の範囲なので1 MeV の高速イオンのエネルギーに比べれば 非常に小さく、質量は数千倍以上も小さいので、軌道方向の変化を考える必 要はなく、エネルギー損失だけを考えればいいことになる。

また、ラザフォード散乱が起こるためには原子核同士が~10<sup>-3</sup> 程度ま で接近する必要があり、結晶の格子定数より~3桁も小さい。

そこで、固体物質中に高速イオンが入射された場合、物質というのは極め て小さな原子核が~数 ほど離れて散在している空間であり、その中の原子 核を例えて言えば、国立競技場内のパチンコ玉くらいの大きさである。そん な空間内にイオンビームを入射した場合に、たまたま原子核の近く(~10<sup>-3</sup>

)を通る場合のみ広角散乱が起こるわけであって、大部分のイオンビーム は散乱せずに直進する。この時、イオンの通り道に存在する電子は、非常に 小さくはあるがイオンビームに対して、プレーキの効果を果たす。

さて、次にイオンのエネルギー損失であるが、単位長さあたりのエネルギー 損失量を阻止能という。RBS 法で用いられるエネルギー範囲では、原子核によ る散乱阻止能に対する寄与(核阻止能)は、電子との散乱による阻止能(電子 阻止能)に比べて圧倒的に小さいので、通常無視する。

ここで、二つの阻止能について簡単に説明しておく。

(a) 電子阻止能

イオンビームなどに対しての微小のブレーキ作用があり、その ブレーキ作用の強さは、イオンが物質中を dx 進むと dE のエネ ルギーを失う(単位長さあたり失うエネルギーの量)として (dE/dx)。で表わされる。

(b) 核阻止能

イオンビームは原子核との衝突による弾性散乱でもエネルギー を失う(単位長さあたり失うエネルギーの量)ので、この効果を 電子阻止能(dE/dx)。に対して、(dE/dx)nで表わす。

これらのことから、物質中にイオンビームが入射されてから後方散乱され て検出器にたどり着くまでのエネルギー損失を以下に述べる。

- (1) 電子阻止能によるエネルギー損失
  - (a) 表面からある深さ X の原子核まで直進する間に失ったエネルギー
  - (b)後方散乱された後、深さ X から逆戻りして検出器に入るまでに失っ たエネルギー
- (2) 核阻止能によるエネルギー損失

(c) 深さ X にある原子核に与えたエネルギー

このとき、核阻止能によるエネルギー損失は物質内原子核の質量で決まる から、その情報より質量分布がわかる。また、電子阻止能によるエネルギー 損失からどのくらいの距離を往復したかにより深さ方向の情報がわかる。

電子阻止能 (dE/dx)。のデータはいろいろな物質について集積されている が、特に、H+と He+ については豊富であって、このことが RBS 法で上記軽 イオンが多く使われることの理由の一つとなっている。(dE/dx)e の値は数 MeV の He+の場合、~50 eV/ 程度(1 すなわち0.1 nm 進むとき 50 eV 前後のエネルギーをイオンは失う)である。そのため、表面から~  $\mu$ m(=x)の深さまでにイオンは約500 keV 程度のエネルギーを失う。 これに対して、低速イオンの後方散乱の場合は、弾性散乱が非常に大きい ため一回散乱の条件が成立しない。したがって、低速イオンでは深さ方向の 情報をもたらす事ができない。

これらの事から、数 MeV の高速イオンが後方散乱されるには、原子核の 中心に約10<sup>-3</sup> (10<sup>-11</sup> cm)程度近づかなければならない。したがって、 その散乱断面積は非常に小さく(10<sup>-12</sup> cm)<sup>2</sup> = 10<sup>-24</sup> cm<sup>2</sup>程度である。 一方、固体物質は1 cm<sup>3</sup>中に10<sup>22</sup>~10<sup>23</sup>個の原子核を含んでいる。 物質が単結晶の場合には、高速イオン群が単結晶全体から後方散乱される マクロな断面積にその結晶性が影響を持つ場合がある。すなわち、イオンの 入射方向が結晶軸(または面)と特殊な関係にある場合には、そうでないと きに比べて、この断面積ははなはだしく小さくなる現象(約2桁)が認めら れる(つまり後方散乱が起こりにくくなる)。このような現象をチャネリング 現象という。

#### 1.4 チャネリング現象

結晶を低指数軸方向から見ると原子列に囲まれた隙間が見える。このよう な隙間をチャネルという。イオンが特定の結晶軸や結晶面(チャネル方向) に平行に入射する場合をアラインド入射(aligned 方向)、そうでない場合を ランダム入射(random 方向)という。図1.3に aligned 方向と random 方向から見たダイヤモンド結晶を示す。







(b) <110>方向から約 10°移動したもの (random 方向)

図1.3

図1.3(a)のようなアラインド入射ではランダム入射に比べ散乱確立 が小さくなり、さらに阻止能が減少するため、入射イオンが結晶の奥深く まで侵入する。この現象をチャネリングという。

#### 1.4.1チャネリング現象を用いた測定例

ここでは、参考文献である編者 大西孝治氏らの固体表面分析の中からチャネリング測定の一例として述べる。下地結晶(Si)とエピタキシャル層(CeO2 薄膜)の結晶方位関係を 1.8MeV のヘリウムイオンを用いたチャネリング測 定を利用して解析したものである。

このとき、下地の Si からの信号と CeO2 層からの信号には散乱エネルギー に差があるので分離して観測できる。試料をゴニオメータにセットし y 軸を 5。傾けて、傾き角を0に固定した状態で1。ずつ回転させながら一定量の ビームを入射し、各領域に対応するエネルギー範囲の RBS イールドを積算 する測定を回転角0~360。の範囲で繰り返して円周上に示して測定を行う。 このとき、極小の値を示した部分は入射イオンビームが面チャネリングを起 こした事を示している。この極小値は円の中心付近を中心に対称で、その2 点 を1 組として結ぶ直線が結晶面を示している。この直線が1 点で交わるとこ ろが結晶軸の位置を示している。そのようにして構成されたグラフ(ステレオ グラフ)の対称性を調べる事で結晶の方位関係を明らかにすることができる。 Siのステレオグラフは4つの {100 } から構成されていて、Siの方位が (100)であることが確かめられる。これに対して、CeO<sub>2</sub>のステレオグラフ は複雑だが、対称性の解析により、90°回転した2つの {100 } 面パターン が重なったものであることがわかる。すなわち、堆積した CeO<sub>2</sub> はダブルド メイン構造を持つ多結晶であり、下地の Si と CeO<sub>2</sub>のエピタキシャル関係 は、(110 ) CeO<sub>2</sub>;(100 ) Si、(001 ) CeO<sub>2</sub>;(011 ) Si であることが、チャ ネリングを利用した R B S分析により判明した。さらに、下地 Si と CeO<sub>2</sub>の グラフを比べてみると、結晶軸を表わす交点の位置が Si の {100 } 面に沿っ てわずかではあるが、ずれている。これを調べるためにイオンビームが {110 } 面に平行になる条件で傾き角を変え、 R B S イールドの角度依存性を測定す ると、 R B S イールドの極小値はずれており、Si の < 100 > 軸と CeO<sub>2</sub> 層の < 110 > 軸が完全には平行でないことが分かる。

次に、堆積した CeO2 層の結晶性を測定したアラインドスペクトルとラン ダムスペクトルを図1.4に示す。



図1.4 Si(100)上に堆積した CeO2 試料のランダムおよびアラインドスペクトル

アラインドスペクトルはイオンビームの入射方向を CeO<sub>2</sub>の < 110 > にあ わせた後、回転軸 y を7°回転し、さらに z 軸を回転しながら入射ビームを 3 µ C 照射して測定している。ランダムスペクトルを回転しながら測定する のは、ビーム入射方向を単に1軸に関して傾けただけでは、軸チャネリング は避けられても面チャネリングは、かならずしも避けられないためであり、 試料が結晶性の場合、再現性のよいランダムスペクトルを測定するには重要 な留意点である。

アラインドスペクトルはランダムスペクトルに比べ、チャネリング効果に よってイールドが減少しており、結晶成長していることが分かる。一方、セ リュウム原子(Ce)によるスペクトルは、結晶表面原子による表面ピークを 除けば表面側から界面側にむかって上昇しており、界面付近で結晶性が悪く なっていることが分かる。以上に述べたように、RBS法はチャネリング効 果測定と組み合わせることにより、単に試料内原子の深さ方向組成分析だけ でなく、結晶性試料中の欠陥分析や不純物原子位置の測定など、適用範囲の 広い分析法なのである。

以上、述べた例からもわかるようにチャネリング測定によって、

(1)結晶性の評価(試料の欠陥を分析)

(2)結晶界面の歪みの検出

などが可能であり、これらは積層構造の資料を解析するにあたって重要な 情報をもたらす。さらに Si 結晶中にドーパントである As などを注入した 試料の例などでは、Si 結晶格子のどこに不純物が存在するかをチャネリング 測定によって知ることができる。

### 2. 人工チャネル

#### 2.1 ガラスキャピラリを用いた人工チャネルの概要

RBS法は前で述べたように試料(固体物質)に高速イオンビームを当て ることにより、その元素組成や深さ方向の分布を測定する事のできる優れた 手法である。しかし、現在の電子デバイスや光デバイスなどの高精細化によ り、入射ビームの直径が1mm程度のRBSでは有効な情報が得られない場合 が多くなってきている。そこで、RBSの面積分解能を簡単に、しかも飛躍的 に増加させたいと考え、ガスキャピラリを使ってイオンビームを収束させてみ ることにした。計算で仮定したガラスキャピラリは、図2.1のようにチャネ リングの臨界角0.5°以下のテーパーを持つもので、これに入射したイオンビー ムは中央に収束され出口から出射されると思われる。



### 図2.1 0.5の臨界角以下のテーパーを持つガラスキャピラリ で入り口の直径は1.2mmで出口が0.1µmである。

図2.1は、図1.3(a)のようなダイヤモンド結晶を<110>結晶軸 方向から見たときのチャネル(原子列の空間)の一つと考えたもので、人工 的なチャネルとして働くことが想定される。 2.2 ガラスキャピラリ内のイオンビームの軌道

まず、ガラスキャピラリ内壁を2本の直線で近似し、その中でのイオンビー ムの軌道を図2.2に示すように、壁面で鏡面反射をくり返す折れ線と考える。



図 2 . 2 二次元の折れ線で表したイオンビーム軌道シミュレーション

キャピラリ内に入射されたイオンビームにはさまざまな作用が働き、実際で はとても複雑になるが、今回は簡単にするためにガラスキャピラリ内に入射 したイオンビームはガラス壁面で鏡面反射するものと仮定して計算を行った。 さらに、2次電子の発生や鏡面反射以外の散乱なども考えないもっとも簡単 な仮定で計算を行うことにする。そのように考えることでイオンビームの軌 道は次のような簡単な方程式で表わすことができる。

イオンビームの入射方向を x 軸、それと垂直な方向を y 軸として、キャピ ラリ入口の中央を原点とすると、イオンビームの(n+1)回目の反射点の座 標(Xn、Yn)は...

 $X_n = A_0 + A_{n-1} / \tan 2_{n-0} + \tan 0$ 

$$y_n = (-1)_{n+1} \cdot a_n - 1 + (-1)^n \cdot X_n \cdot \tan 2_{n-0}$$

ただし、

$$\mathbf{a}_n = \mathbf{X}_n \cdot \tan 2(n+1) \quad _0 + (-1)^n \cdot \mathbf{y}_n$$

は、n (n = 1 , 2 , 3、・・・)回反射後のトラジェクトリーを表わす直線の y 切片である。

これらから、入射したイオンビームはガラス壁面で反射するたびに壁面に対す 角度をテーパー角だけ増加させながら進んでいく事がわかる。



図 2 . 3 テーパー角が 0.5 °、入り口の内径 1.0mm、出口の内径 0.1 µ m 長さ 57.3mm のガラスキャピラリ

上記で述べたような条件のもとで図2.3のような、直線のガラスキャ ピラリについての軌道計算を行ってみる。このとき、最も外側から入射した イオンビームは56.8mm 付近までしか進まず出射されない。次に中心軸から ±5µmのところから入射したイオンは出口まで到達して出射することができ る。その他のところからも入射してみたが、結局±5.7µm以内のところから 入射したイオンしか出射されないことがわかった。このとき出口付近のトラ ジェクトリのようすを図2.4に示す。



[mm]

図2.4 図2.3の出口付近の拡大図

### 2.3 ガスキャピラリ内壁によるイオンビーム散乱の角度分布計算

これまでに述べてきたようなガラス壁面で鏡面反射する場合では、種々の 物理的現象を無視するうえに、入射イオン数を1個の原子と考えて計算を行っ ているため、最も簡単な計算で結果を得ることが可能であった。しかし、こ のような仮定では単純すぎて現実的ではなく、実際に出てくるであろう結果 と、だいぶ異なってくると考えられる。これをもう少し現実的にシミュレー ションするためには、物理的現象を考えたうえで計算を行う必要がある。し かし、考えられるすべての現象を考慮して計算を行うと、非常に複雑になる。

ここでは、ラザフォード散乱の散乱断面積の角度依存性、すなわち

() sin<sup>-4</sup> /2、を考慮に入れてガラスキャピラリ出口付近での散乱イオンの角度分布計算を行った。本来ならば長いキャピラリの全領域にわたってこのような計算を行えばより現実に近いシミュレーションとなるが、出口付近での計算だけでも鏡面反射だけを考えた場合との比較のためには十分役に立つと考えられる。

まず、図2.5に散乱断面積の角度依存性を計算した結果を両対数グ ラフで示す。

16



図 2 . 5 角度 に対する相対断面積の変化

図2.5のグラフからも明らかなように、散乱断面積は相対的に前方散乱 (=0°)が圧倒的に大きく が大きくなるにつれて急激に減少する。 なるべく多くのイオンを出口から取り出したいという本研究の本来の目的 からいえば、この傾向は一面ではガラス中に侵入して失われるイオン数が 増加するので好ましくないが、他方、鏡面反射だけを考えていたときに比 べればキャピラリ出口を通過するイオン数が飛躍的に増加するという好ま しい結果をもたらす。図2.6にこのようすを模式的に示す。





鏡面反射ではキャピラリ中心軸から0.15µm以内に入射したイオンし か出口から出られないが、強い前方散乱のおかげで多くのイオンが出口 を通過できることがわかる。図2.6で散乱角が0~0.5°のイオンは ガラス内に侵入し失われる。散乱角が0.5°~1.0°のイオンは出口を通過 してくる。散乱角が1.0°より大きいイオンは反対側のガラス中に侵入して 失われる。これらがどのくらいの割合で起こるかを断面積の積分

$$\int \frac{d}{\sin^4 \left( \frac{1}{2} \right)}$$

より求めると、ほぼ

14000:22:1

の比率となる。すなわち、約0.15%のイオンが出口から出てくることになる。この値は、まだ実用的とはいえないが、鏡面散乱だけを考えていれば ゼロであったものが、単純なラザフォード散乱の断面積に従うと仮定した だけで0.15%にも増加する結果が得られた、ということで、前途に希望を 持たせるものである。

#### 3.考察および結論

根引らの鏡面散乱による全反射を仮定した軌道計算では直径 1mm の 入口に入射したイオンのうち、中心軸からわずか±5.7µm以内に入射 したイオンが出口から出てくるという結果であった。しかし、この全反 射の仮定は常にチャネリング条件が満足されていれば、ほぼ成立すると 考えて良いが、実際には壁面に対するイオンの入射角が徐々に大きくな るので成立しない。したがって、この効果を考えれば入口から出口への イオンの透過率は大幅に低下するはずである。

これに比べて、本研究のように散乱イオンの角度分布を考えれば、 断面積が前方散乱では非常に大きいという事実によって透過率は、か なり改善される可能性がある。さらに、今考えているような小角散乱 ではガラス表面の電子による寄与がイオンビームを曲げる上で無視で きない効果があることが知られていて、この効果もイオンビームの透 過率を増加させる方向に働く。

以上まとめると、本論文では、まずRBS法の基本原理について述 べ、ついで細いガラスキャピラリ内のイオンビームの軌道計算を行 った。軌道計算では、ガラス壁面によるイオンの全反射を仮定した 根引らの計算を再確認し、さらにラザフォード散乱の断面積の角度分 布を考慮に入れた場合を簡単なモデルで計算した。まだモデルが単純 すきるのでここで得られた結果がすぐに実験的にも得られるとは考え られないが、これまでの結果を幾分は改善できるものと思われる。

#### 参考文献リスト

1. 根引拓也、山本哲也、成沢忠 共著:第 62 回秋季応用物理学会 予稿集
 第 2 分冊(2001.)

 平木昭夫, 成沢忠 共著:(応用物理学会)表面・界面の分析と評価 (オーム社 1994.6)

3. 大西孝治・堀池靖浩・吉原一紘 共著:固体表面分析< > (講談社 1995.4)

4. 金子洋三郎 著:[化学のための] 原子衝突入門 (株) 培風館(1999.5)

- 5. 笹川辰弥 著:(物理学選書 20) 散乱理論 (株) 裳華房(1991.3)
- 6. 市川行和 著: 衝突する原子(株) 丸善(1985.1)
- 7. 村田好正・八木克道・服部健雄 著:(アドバンスエレクトロニクス シリーズ1-19)固体表面と界面の物性 (株)培風社(1999.3)
- 8. 小間篤・八木克道・塚田捷・青野正和 著:(表面科学シリーズ)表面科学入門(株)丸善(1994.11)
- 9. 藤本文範・小牧研一郎 著:イオンビーム工学(内田老鶴圃 1995.2)
- 10. 藤本文範 著:イオンビームによる物質分析・物質改質(内田老鶴圃 2000.3)

#### 謝辞

今回の論文を作成するにあたって、親切なご指導、ご支援を頂いた高知工科 大学工学部電子・光システム工学科、成沢忠教授に深く感謝いたします。 また、常日頃から御指導、御助言を頂きました高知工科大学工学部電子・光 システム工学科の教授、助教授および数多くの方々のご支援を頂き重ねて感謝 の意を申し上げます。

そして、本研究を進めるにあたってご協力頂いた高知工科大学工学部電子・ 光システム工学科、根引拓也氏に感謝いたします。本当にありがとうございま した。